

Via Filling

Plnicí pasta (plnič otvorů) slouží k vyplnění VIA otvorů v HDI / SBU aplikacích. Pastu můžeme aplikovat pomocí šablony nebo metodou síťotisku.

Výrobce	Název výrobku	Použití	Specifikace
TAIYO	<u>THP-100DX1</u>	otvor je kompletně zaplněn nevodivou pastou, slouží k zaplnění pohřbených otvorů, k zabránění protečení pájky na stranu součástek	<ul style="list-style-type: none">> otvor po nakovení: min. 0,1 mm> otvor po nakovení: max. 2,0 mm> aspect ratio pro prokovené otvory: max. 40:1> aspect ratio pro slepé vrtání: max. 1:1> dle specifikace IPC-4761 jsme schopni zajistit typy zaplnění: V, VI-a, VI-b a VII> velikost DPS: min. 200 x 200 mm> tloušťka DPS: 0,4 - 3,2 mm